



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12524

检测报告

样品名称：集成电路

型号规格：XCF01SVOG20C

器件品牌：XILINX

委托单位：

深圳市创芯在线检测服务有限公司

2025 年 11 月 17 日



检 测 报 告

公司：

地址：

样品名称：集成电路

型号：XCF01SVOG20C

器件品牌：XILINX

批次代码：20+

器件封装：TSSOP-20

样品数量：1 片

检测数量：1 片

收样日期：2025/11/12

测试日期：2025/11/13/10:00 - 2025/11/14/18:00

报告专用章

检 测 _____

审 核 _____

批 准 _____



测试项目及结论

结果分析			结论
根据委托方要求，对所送1只样品进行了X射线检查共1项检验。 未检测到标准缺陷。			✓
测试项目	总数量（片）	检测标准	结果
<input checked="" type="checkbox"/> 文件与包装检查	1	N/A	✓
<input type="checkbox"/> 外观检测	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 丙酮测试	N/A	N/A	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> X-ray检测	1	GJB 548C-2021 方法 2012.2	✓
<input type="checkbox"/> XRF检测	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 电特性测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 编程烧录	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 关键功能测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 声学显微镜检查	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 可焊性测试	N/A	N/A	N/A
<input type="checkbox"/> 开盖测试	N/A	N/A	N/A

结果状态： ✓ 可接受 ✗ 不可接受 ● 可疑的 N/A 未测试&不适用

测试设备

设备名称	编号	型号	校准有效期至
光学显微镜	TC-S-WG-007	SEZ-260	2026/07/07
X-射线探伤机	TC-S-WS-001	X6600	N/A
检测依据 《XILINX XCF01SVOG20C》：			
https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds123			

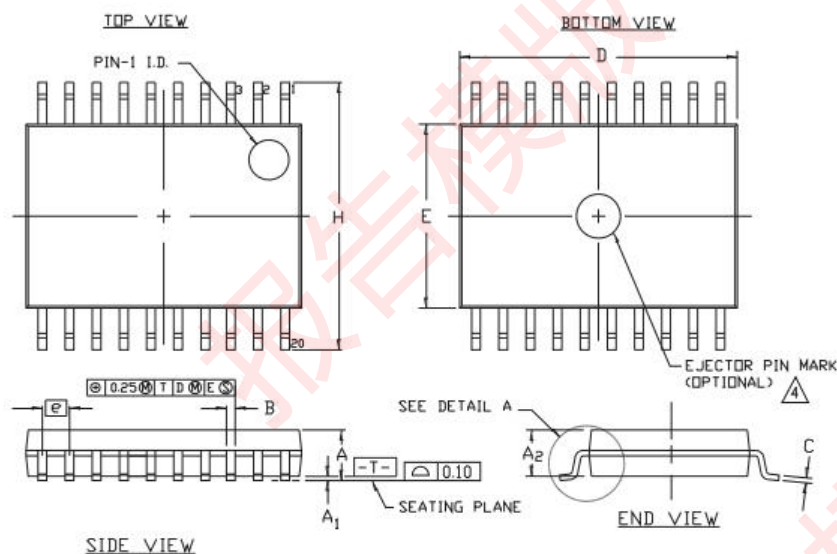
1. 芯片描述:

Xilinx推出了Platform Flash系列系统内可编程配置prom。这些prom提供1到32 Mb的密度,为存储大的Xilinx FPGA配置位流提供了一种易于使用、经济高效且可重新编程的方法。平台Flash PROM系列包括3.3V XCFxxS PROM和1.8V XCFxxP PROM。

2. 封装尺寸:

XILINX
PK068 (v1.4) March 12, 2012

TSSOP (VO20/VOG20) Package



	MILLIMETERS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	--	--	1.19
A ₁	0.05	0.10	0.15
A ₂	0.79	--	1.04
B	0.18	--	0.30
C	0.10	--	0.20
D	6.40	6.50	6.60
E	4.29	4.39	4.47
e	0.65 BSC		
H	6.20	6.40	6.60
L	0.50	0.60	0.75
α	0°	5°	8°

NOTES:

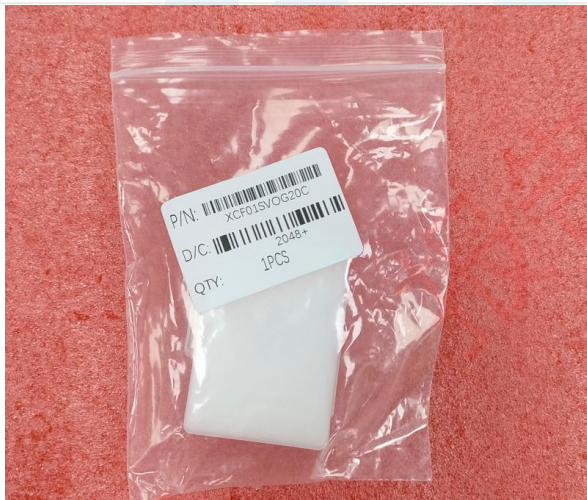
1. ALL DIMENSIONS AND TOLERANCES CONFORM TO ANSI Y14.5M-1982.
2. DIMENSION "D" DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE MOLD PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.15mm PER SIDE
3. DIMENSION "E" DOES NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE MOLD PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25mm PER SIDE
4. EJECTOR PIN MARK IS A ROUND IMPRESSION MADE BY MACHINE DURING ASSEMBLY PROCESS
5. LEAD FINISH: VO20 - 85/15 (Sn/Pb)
VOG20 - 100% Matte Sn
6. CONFORMS TO JEDEC MO-153-AC

pk068_01_002812

3. 文件与包装检查：

外箱数量	N/A	外箱尺寸 (cm)	N/A
内箱数量	N/A	内箱尺寸 (cm)	N/A
总重量	15 g	批次	20+
产地	N/A	批号	N/A
来料数量	1片	采样数量	1片
防潮保护	N/A	ESD保护	N/A
样品编号(批次+序号)	20+-#1		

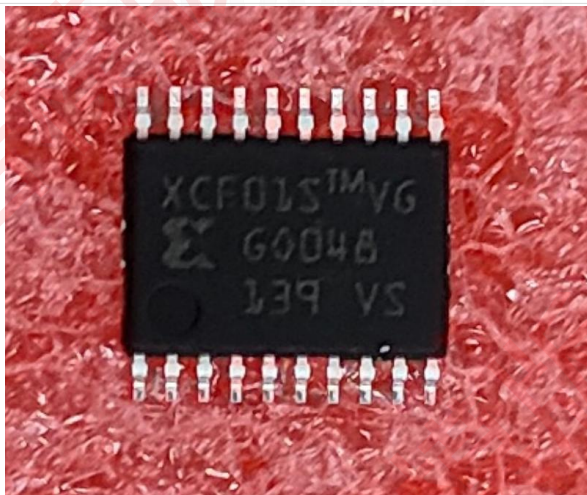
来料图片-1



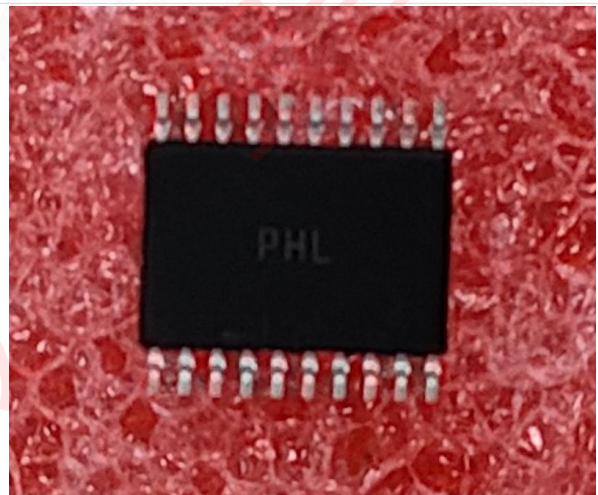
来料图片-2



来料图片-3



来料图片-4



4. X-ray检测：

依据标准：**GJB 548C-2021 方法 2012.2**

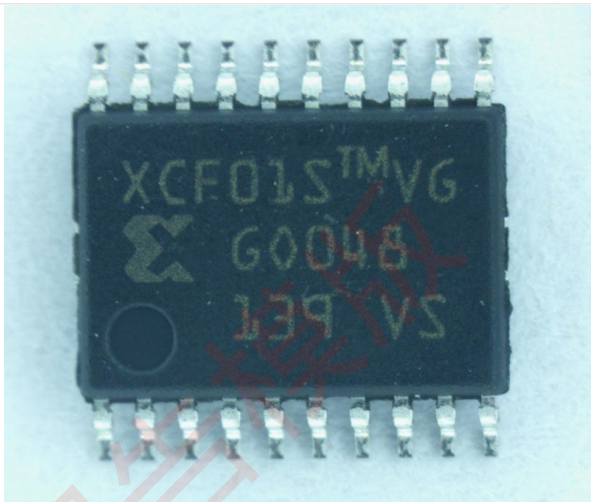
环境温度：25±3 °C 相对湿度：45%~65% RH

客户提供制造商为**XILINX** 型号**XCF01SVOG20C** 的 1 片用于分析，1 片样品（#1）进行 X-Ray 测试。详情如下：

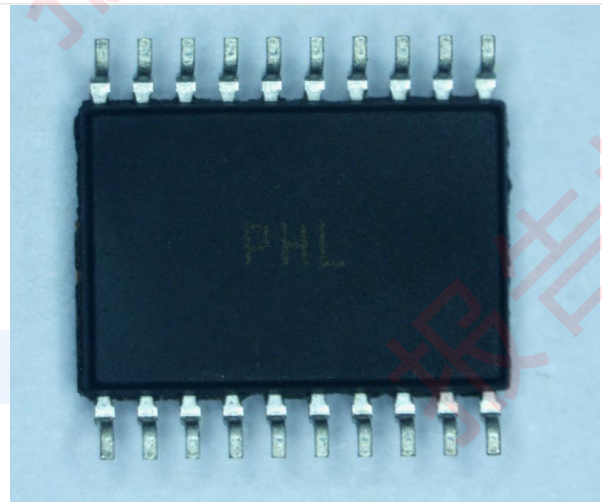
X-Ray 检测样品 1 片，未发现键合丝及结构异常。1 片样品 X-ray 检测通过。

样品编号	检查项目	结果
#1	内部晶圆是否存在裂纹、粘接倾斜或超出粘接范围的异常	通过
	内部键合丝是否断裂、交丝、弧度超标、焊点脱焊异常	通过
	内部引线架和基板结构是否异常	通过
	内部粘接界面的空洞是否异常，是否存在粘接料与主体分离，粘接料累积过高异常	通过
	侧视图内部的粘接料爬升高度、键合丝弧度、键合丝与顶部间距、一二焊点是否存在异常	通过
	样品内部是否存在超出0.025mm的附着或游离颗粒物，是否为金属材质	通过

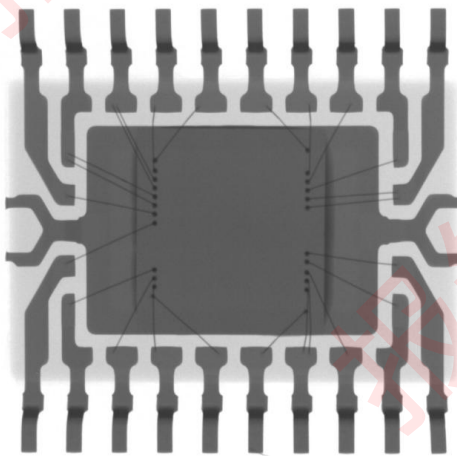
正面



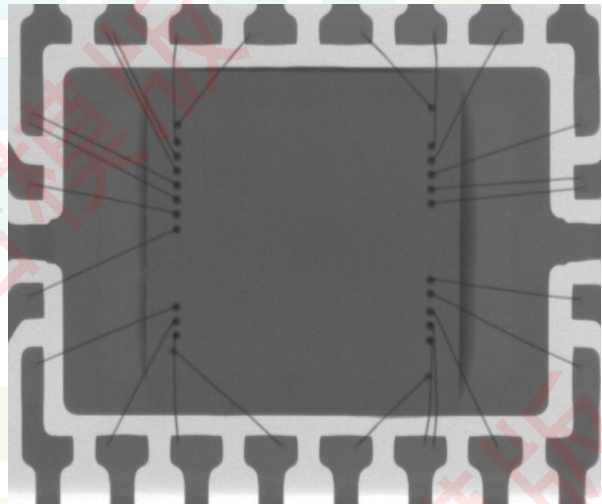
背面



#1-正面形貌



#1-正面放大形貌



#1-侧面形貌



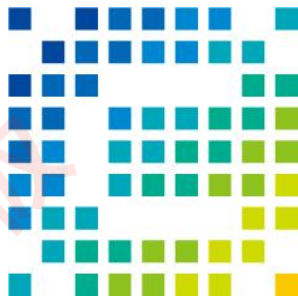
#1-侧面放大形貌



-报告结束-

声 明

1. 检测报告无“公司报告章”及“骑缝章”无效。
2. 复制检测报告未重新加盖“公司报告章”及“骑缝章”无效。
3. 检测报告中无检测、审核、批准人签字视为无效。
4. 检测报告涂改、部分提供和部分复制无效。
5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 检测报告仅对收样检测结果负责，不对批量产品质量负责。
7. 加*者为分包检测数据。
8. 报告加盖 CMA 标识，表示检测项目在资质认定范围内；未加盖 CMA 标识，表示部分/全部检测项目未在 CMA 资质认定范围内，结果仅供委托方内部使用。



CXO 实验室公众微信号

电话：0755-83762185

邮箱：engineer@iclabcn.com

网站：<https://www.iclabcn.com>

地址：深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路393号英达丰工业园A栋2楼